

- 本ワークショップは恒例の聴講者参加型を特徴としています。
- ワークショップの醍醐味である異分野、競合を超えた技術者間の交流の場を重視。業界の著名な先生方をナイトセッション講師として実装業界の将来像を語って頂きます。各講師毎グループを作って討議。事前希望で振分。

日時： 2016年 7/14 (木) 18:00 ~ 7/15 (金) 18:00
 開催場所： ラフォーレ琵琶湖 滋賀県守山市今浜町十軒屋 2876 077-585-3811

* ナイトセッション(1日目) 「新分野を切り開く実装技術」

講師5名のショート講演の後、各講師グループに分かれて討議。事前希望でグループ分け

- | | | |
|-----------|-----------------|---|
| A. 大倉 華雪氏 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 「再生医療実用化にむけて乗り越えるべき課題」
~お力をお貸しくださる方はおられますか?~ |
| B. 西尾 俊彦氏 | SBRテクノロジー 代表取締役 | 「ムーア則の終焉からニューロコンピュータ出現までのギャップをどうカバーするのか?」 |
| C. 折井 靖光氏 | 日本IBM | 「IoT時代における超低消費電力脳型デバイスと人工知能」 |
| D. 関口 義雄氏 | オムロン | 「IoTと実装に求めるもの」 |
| E. 小岩 一郎氏 | 関東学院大学 教授 | 「イノベーションのジレンマと日本ワールドカップでさくらジャパンが教えてくれたもの」 |

*事前申し込みの方々には、一緒に語り明かしたいナイトセッション講師を選択頂けます。

* ワークショップ(2日目)

- | | | |
|--------|-----------------|-------------------------|
| 大倉 華雪氏 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 「再生医療の向こう側」 |
| 西尾 俊彦氏 | SBRテクノロジー 代表取締役 | 「10年後のパッケージテクノロジーを大胆予想」 |

* ポスターセッション 36件

- MEMS
「MEMS 熱式フローセンサ」 オムロン(株) 山本克行氏
- 3Dパッケージ
「高精度ウエハレベル Cu-Cu 接合プロセスの解析支援・最適化」 (株)ニコン 三ツ石創氏
「Sn-Ag系薄膜接合による3D-IC実装プロセスに関する研究」 大阪大学 岩田剛治氏
「ファインピッチCoW実装における熱挙動解析」 東レエンジニアリング(株) 朝日 昇氏
「3次元実装 TSV への無電解めっきによるバリア・シード形成技術」 関西大学 平手博史氏
「CuSn ナノツリーの形成とフレキシブル材料への高密着性電極形成」 関西大学 金子直人氏
- 基板・材料・ナノペースト
「薄膜 Si ひずみセンサを用いた、Cu ワイヤボンディングのリアルタイム計測」 九州大学 岩鍋圭一郎氏
「IoT 時代のものづくりを指向した低温硬化型導電性ペースト」 セメダイン(株) 岡部祐輔氏
「無機接着剤の現状と今後」 朝日化学工業(株) 中根久志氏
「伸縮自在なストレッチャブル樹脂フィルム」 パナソニック(株)オートモティブ&インダストリアルシステムズ社 阿部孝寿氏
「低伝送損失基板を実現する低誘電・高接着ポリイミド樹脂「PIAD」」 荒川化学工業(株) 田崎崇司氏
「マイクロナノ複合銅粉と導電性銅ペースト」 積水化学工業(株) 大西重治氏
「防曇+防汚フィルム」 デクセリアルズ(株) 水野幹久氏
「新規無溶剤型紫外線硬化性樹脂 UV ブラック」 共栄社化学(株) 池田順一氏
「高熱伝導性熱硬化型絶縁接着フィルムの開発」 ナミックス(株) 小松史和氏
「銅ナノ材料(仮)」 協立化学産業(株) 朽木幹春氏
- 装置技術・評価・信頼性
「ラマン分光法を用いた半導体パッケージの応力解析」 (株)東レリサーチセンター 伊藤元剛氏
「局所加熱による低耐熱性材料への部品はんだ接合技術」 東レエンジニアリング(株) 田嶋久容氏
「動的粘弾性測定を用いた両面粘着テープの繰返しクリープ評価」 (株)富士通研究所 古山昌治氏
「最新【国産ピコ秒パルスレーザ】のご紹介と【微細レーザ加工】のご提案」 スペクトロニクス(株) 南 信男氏
「卓上型低真空走査電子顕微鏡のご紹介(仮)」 日立ハイテクノロジーズ 未定
- パワエレ
「高放熱金属基複合材料/Al-Diamond の開発」 デンカ(株) 石原庸介氏
「高熱伝導特性を目指した酸化亜鉛フィラーの設計と材料開発」 石原産業(株) 細川拓也氏
「カーボンナノチューブを用いた高熱伝導放熱材料の研究」 (株)富士通研究所 廣瀬真一氏
「Ag ナノポーラスシートを用いた接合技術」 大阪大学 KIM Min-Su 氏
- プリント
「3次元曲面印刷の開発現状と展望 ~ソフトプランケットグラビア(SBG)技術~」 山形大学 泉 小波氏
「パワー半導体接合に適した新規溶剤「セルトール OG」」 (株)ダイセル 鈴木陽二氏
「導電性接着剤の熱伝導率に対する金属ナノ粒子の添加効果」 ハリマ化成(株) 中城治之氏
「3次元曲面印刷の開発現状と展望 ~全方向インクジェット(OiJ)技術~」 山形大学 吉田泰則氏
- めっき
「単結晶 Si および SiC ウェーハ上への直接無電解めっき」 兵庫県立大学 八重真治氏
「超微細回路形成に適した表面処理技術」 奥野製薬工業(株) 喜多あずさ氏
「ビルドアップ絶縁材上の無電解銅めっきの化学密着メカニズムに関する検討」 (株)JCU 中川翔太氏
「高密度配線に適した無粗化内層銅表面処理技術」 石原ケミカル(株) 山村岳司氏
「Cuワイヤーボンディング対応無電解UBMめっき」 大和電機工業(株) 藤森友之氏
- ライフサイエンス
「医療機器部材向け機能性表面処理技術」 トーカロ(株) 三木真哉氏
「液晶アクチュエータ開発に向けた取り組み」 産業技術総合研究所 武仲能子氏

参加費 ●前泊2日間コース (会員) 35,000円
(非会員) 35,000円

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> * 夕暮れレセプションパーティー * 宿泊費 | <ul style="list-style-type: none"> * ナイトセッション * 2日目ワークショップ参加費
(朝食、昼食費は含まれません) |
|---|---|

●日帰り1日コース (会員) 19,800円 (非会員) 25,000円

[2日目ワークショップ参加費のみ (朝食、昼食費は含まれません)]

*申し込みは開催10日前まで受け付けますが、トータル100名になり次第締め切らせて頂きます。
*会員価格は、JIEP会員ならびに協賛団体会員の方を対象といたします。

参加申込み：エレクトロニクス実装学会ホームページ <http://www.e-jisso.jp/event/index.html> より
お願いいたします。

予定

7/14 (木)

15:00~18:00	チェックイン	(自由時間)
18:00~20:00	レセプション	(立食パーティー)
20:00~21:00	ナイトセッション1部	(講師5名のショート講演)
21:00~22:00	ナイトセッション2部	(各講師毎のグループへ分かれて討議)
22:00~	ナイトセッション3部	(各講師5部屋へ移動 自由集合)



展望レセプション

7/15 (金)

8:00~ 8:45	モーニングセッション
8:45~ 9:00	オリエンテーション (2日目日帰りコースの参加)
9:00~10:00	ポスター アブストラクト トーク
10:00~11:00	講演会 第1部
11:00~12:00	講演会 第2部
12:00~13:45	昼休憩
13:45~17:45	ポスターセッション
17:45~18:00	閉会



講演会



モーニングセッション

関西ワークショップ2016



ナイトセッション



ナイトセッション全員写真



ポスターセッション

<p>宿泊</p> <p>GUEST ROOMS リゾート感溢れる客室</p> <p>琵琶湖を一望する贅沢なロケーションのお部屋や、カジュアルにお過ごしいただけるお部屋などをご用意。ご滞在スタイルにあわせてお選びください。</p>  <p>総合リゾートホテル ラフォーレ琵琶湖</p>	<p>自由時間</p> <p>FACILITIES 多彩な付帯施設</p> <p>国内ホテルで唯一の本格的プラネタリウムは、迫力映像とサウンドが自慢。その他、体育館やプール、テニスなどのスポーツ施設も充実しています。</p> 	<p>交通機関</p> 
--	--	--

JR湖西線堅田駅 (京都から約25分) より送迎有・・・(7月14日) 16:30 (7月15日) 8:30 終了時 18:15 堅田駅行
JR琵琶湖線守山駅より路線バス (約40分)

主催 エレクトロニクス実装学会 関西支部 【問い合わせ先】 E-mail: ws-kansai@jiep.or.jp

[協賛：日本ロボット工業会 (JARA)、日本電子回路工業会 (JPCA)、表面技術協会、日本機械学会、
溶接学会マイクロ接合研究委員会、日本材料学会、日本信頼性学会、日本金属学会、日本接着学会]

*発表テーマは仮題とします。講師、内容は変更になる場合があります。また、ご希望のセッションやポスターが選定されない場合もありますので予めご了承下さい。